

2003年8月21日

世界半導体生産能力・稼働率の2003年第2四半期(4-6月)の統計数値公表

世界半導体生産キャパシティ統計(SICAS: Semiconductor International Capacity Statistics)では、この度2003年第2四半期(4-6月)の数値がまとまったので公表いたします。別添の資料に、今期の数値、前期比伸長率および前年同期比伸長率を、生産能力と実投入数のすべてのパラメータについて記載し、合わせて生産稼働率も記載してありますので、詳細はそちらを参照してください。

SICASは1995年2月24日に発足し、世界の5業界団体(EECA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA)の支援の下に、現在世界の主要半導体メーカ約50社が会員として参加しています。

- ・EECA: European Electronic Component Manufacturers Association (欧州電子部品工業会)
- ・JEITA: Japan Electronics & Information Technology Industries Association (電子情報技術産業協会)
- ・KSIA: Korea Semiconductor Industry Association (韓国半導体産業協会)
- ・SIA: Semiconductor Industry Association (of the US) (米国半導体工業会)
- ・TSIA: Taiwan Semiconductor Industry Association (台湾半導体産業協会)

参加会員は四半期毎に年4回、そのIC生産能力と生産稼働実績を、地域別に委託した第三者のデータ集計機関に送付する。データは集計機関により集計され、最終的には中央集計機関によりまとめられ、世界計の集計データとなり発表される。

データの秘密保持のため、会員を含むいかなる関係者(データ集計機関を除く)も、公表される「世界計のデータ」以外を知り得ない仕組みとなっている。

参加会員は、各々自社の世界全体の生産能力と稼働実績を連結ベースで把握し報告するが、他の半導体メーカに生産委託している部分は含まない。生産能力・稼働実績のいずれもウェハ枚数を単位とし、集計期間内の累積枚数を週当たりの平均値に換算し「千枚/週」の単位で報告する。報告方法は以下のとおり。

MOS ICは、加工精度により0.7ミクロン以上、0.4ミクロン以上0.7ミクロン未満、0.3ミクロン以上0.4ミクロン未満、0.2ミクロン以上0.3ミクロン未満、0.16ミクロン以上0.2ミクロン未満、0.16ミクロン未満に分けて8インチウェハの枚数に換算、パイポーラICは加工精度の分類はなく、5インチウェハの枚数に換算。またMOS IC生産能力のうち8インチウェハの生産能力について、実枚数のデータも併せて集計。また生産能力については、1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。なお、2002年第1四半期から、全体の内数としてのMOSファクトリー生産能力とその稼働率の切り出しが行われるようになり、SICAS統計加盟会社44社のうち5社がファクトリー統計に参加している。

SICASへの参加は任意であり、いかなるICメーカ(5つの支援業界団体のどれにも属さないメーカも含む)に対してもオープンである。SICASの統計数値は四半期毎に公表される。SICASの公表数値は、参加会員だけでなく誰にでも入手可能であり、前述の5業界団体から

入手できる。

SICAS の運営組織は会員から選出された代表者で構成されている。現在、事務局はオランダに設置されている。

SICAS の統計は、世界の IC 生産能力とその稼働実績に関する信頼に足る情報をタイムリーに提供するものである。このような情報は、IC 製造設備の急速な技術革新や IC 技術の各世代毎に必要な設備投資額が肥大化していることなどを考えると、半導体及び関連産業にとって有用な参考情報となることが期待される。

なお、日本地域の運営組織として、SICAS Japan が 95 年 1 月に設立されている。

問い合わせ先：SICAS-JAPAN

事務局長 和泉 正

TEL/FAX: 045-832-7762 e-mail <t-izumi@c3-net.ne.jp>